



Hochfrequenz-PCB

Aufgrund immer höher werdenden Taktraten und der Miniaturisierung von Bauteilen sind Leiterplatten mittlerweile zu Hochgeschwindigkeitsautobahnen gereift, die jede Sekunde Millionen von Informationen übertragen. Die Leiterplatte in der HF-Technik muss somit immer schnellere Signalflüsse d.h. höhere Übertragungsfrequenzen beherrschen – die Leiterplatte in der HF-Technik ist somit als ein aktives Bauteil zu betrachten.

Dies erfordert bei der Umsetzung des Leiterplatten-Designs in der Platinenherstellung ein hohes Maß an Know-how, Erfahrung und Prozesssicherheit.

Ausschlaggebend für die Funktionsfähigkeit von Hochfrequenz-Leiterplatten sind vor allem die Leiterbahngeometrie, der Lagenaufbau und die Dielektrizitätskonstante (ϵ_r) der verwendeten Materialien, sowie die Ausführung von Oberflächenmetallisierung. Die VAAS HF-Technologie garantiert bei allen Arten von PTFE-Materialien zuverlässige Durchkontaktierungen und haftfeste Lackbeschichtungen.

Bei höchsten Anforderungen an die Genauigkeit wird die Platine im Direktbelichtungsverfahren strukturiert, der Kupferaufbau erfolgt mit einer speziellen Metallisierungstechnologie, welche eine Genauigkeit von 5 % gewährleistet.